

TGP 88A 反应型导热脂 产品技术数据表

提升系统可靠性

高导热性能

低成本

简介

TGP 88A 系列导热胶是一种反应型导热硅脂，在应用过程中可形成极薄的键合层厚度 (BLT)，并有效消除粗糙界面处的微气泡。该材料可在 65 °C 条件下固化，在金属—金属界面之间表现出优异的粘接性能。TGP 88A 结合了导热硅脂、导热凝胶、导热垫片及相变材料的综合优势，同时避免了这些传统热界面材料各自的缺点。该产品具有低成本、高导热性能及优异的可返修性，有效克服了传统导热硅脂的“泵出”问题，以及导热凝胶、导热垫片和相变材料成本较高的不足。TGP 88A 可作为热界面材料，广泛应用于 LED、笔记本电脑、台式电脑及其他高功率电子器件。

物理特性

产品名称	TGP 88A 导热胶黏剂
填料	氧化铝
树脂类型	环氧树脂
未固化材料性能	
外观	灰色
比重 (ASTM D 1475-60)	1.8 – 2.0 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	20 – 50 kcp
固化后材料性能	
拉伸强度 (Mpa)	16
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	30
导热系数(W/m·K)	10 – 20
杨氏模量 (GPa)	12

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

TGP 88A 可在 88 °C 条件下固化 3 小时。

储存与保质期

在低温条件(7 °C)下, 如材料保持于密封的原始容器中, 保质期为 6 个月。
超过该存储期限, 材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

TGP 88A 为环保、无毒材料。但在使用和操作过程中, 仍建议遵循一般工业卫生操作规范。
如需了解更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SDS (安全数据表)

包装规格

TGP 88A 系列浸涂型胶粘剂提供 5 cc、10 cc 及 30 cc。亦可根据客户需求提供其他包装形式, 订购详情请联系 YINCAE。